

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

圣邦微电子（北京）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20170714

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称	太平洋证券 天风证券 信达证券 浙商证券 东兴证券 安信证券 北京半导体协会 天弘基金 国寿安保基金 平安银行 民生加银基金 民生信托 方正富邦基金 枫瑞资产 华安资产 星石投资 民生 资管 上海攸道投资管理中心
时间	2017年7月14日
地点	首都师范大学（北一区）国际文化大厦南楼二层第六会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：张世龙 董事、副总经理、董事会秘书：张勤 副总经理：谭磊 财务总监：张绚 证券代表：赵媛媛
投资者关系活动主要内容介绍	一、 公司情况介绍 圣邦股份前身是圣邦有限，成立于2007年，专注于高品质、高性能模拟集成电路产品的设计及销售。2017年6月6日登陆资本市场，是首家A股上市的专注于模拟集成电路设计的企业。 公司目前共有十六大类，超过800种产品，应用领域覆盖通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器和汽车电子等；终端产品包括手机、数码相机、平板电脑、可穿戴设备、无人机、病床监护仪、车载娱乐系统等；终端客户包括联想、中兴、小米、金立、

TCL、长虹、创维、康佳、海尔、海信、海康、大疆、夏普等知名厂商。

公司已获得 19 项发明专利、12 项实用新型专利，17 项注册商标，68 项集成电路布图设计证书，另有 16 项发明专利已进入实审阶段。

公司是“国家千人计划”领军企业，曾获得国家级高新技术企业、集成电路设计企业、北京市设计创新中心、中关村新锐百强企业、中关村高成长企业 TOP100、海淀区重点企业等多项资质和荣誉。公司的产品也曾获得国家重点新产品、国家火炬计划、北京市科学技术二等奖、三等奖、中国半导体创新产品与技术奖等多项荣誉。

公司 2014 年至 2016 年营业收入分别为 3.26 亿、3.94 亿和 4.52 亿元，归属于母公司股东的净利润分别为 5990 万、7036 万和 8069 万元，均实现稳定先行增长。

二、 问答环节

1、 模拟芯片和数字芯片设计公司有什么不同？

答：模拟芯片产品数量众多，同一款产品的生命周期较长，应用范围可以横跨多个领域，且降价较慢，所以业绩较为稳定，很难大起大落。数字芯片更新换代更快，所以产品开发节奏很重要，一旦某款芯片推出的时点合宜，则会形成爆款，公司营收会大幅增加，如果某款芯片没有被市场接受，则可能影响公司业绩。

2、 如何应对当前 SOC 集成度越来越高的趋势？

答：数字芯片的集成度越来越高是趋势，但随着新应用的不断涌现，新的模拟芯片需求也不断产生。另外，由于受到工艺等一些因素的限制，不是所有的模拟芯片都可以集成。为了定义新功能，实现产品的差异化，单一数字芯片是无法解决的，需要搭配不同功能的模拟芯片才可以实现。近年来模拟芯片的需求量及在全球芯片市场的占比呈上升趋势。

3、 公司的研发团队建设状况是？

答：公司过去几年每年增加 20%的研发人员，未来希望可以提高速度，每年研发人员增加 25-30%。

4、 公司项目开发的进展情况？

答：公司现在已有逾 800 款新品；目前有 108 个项目在研，共计 300-400 款新品；预计今年可以量产 40-50 个项目，约 150-200 款新品。项目开发时间不同，从 9 个月到 2-3 年都有，平均 1-2 年。

5、 公司未来的产品规划？

答：历史研发投入大约 2 亿，而募投项目是 4 亿，考虑到新产品日趋复杂，研发投入加大、周期延长，未来 3 年至少可以把产品品类翻一倍。

6、 公司的产品有何优势？

答：超低功耗运放放大器以及超低功耗比较器，静态电流可以 300nA，是业内最低；超低功耗 DCDC 转换器，功耗可以做到 1uA 以下，也处于业内领先水平。上述低功耗产品适用于物联网，移动终端产品应用 4A 大电流闪光灯驱动；1:2000 大动态背光驱动；3.5A 的 Switching Charger 等也是公司的主打新产品。

7、 公司在手机技术变革方面是否有产品准备？

答：手机领域和模拟芯片相关的新应用有：无线充电，Audio，USB Type-C 接口，快充等。公司有相关准备，并将推出相关产品。

8、 汽车电子、物联网新应用方面是否有公司的产品？

答：汽车电子方面：公司有一颗运放，通过了 AEC-Q100 测试，用在动力系统，目前已有车企投入使用。

物联网新应用方面：共享单车解决方案里包括圣邦的多颗芯片，如开锁马达驱动，蜂鸣器驱动，GPRS 供电 DCDC，充电芯片等；智能音箱方案里有圣邦的低噪声可调增益的运放放大器、高保真的模拟开关、电源芯片等产品；扫地机器人、无人机可使用圣邦的运算放大器、比较器、LDO、负载开关、音频放大器和模拟开关等。以上方案均有知名厂家采用。

9、 请介绍一下公司下游市场情况。

答：目前公司手机领域的销售额占了接近 40%，其他消费电子接近 40%，工业医疗 20%多。公司规划继续加大工业医疗领域芯片的开发投入，让三大下游市场的芯片销售各占三分之一。

10、 请分别介绍一下公司手机业务、工业应用的情况。

答：手机业务：每年有超过 1 个亿的手机在采用圣邦股份的芯片。下游客户较广中兴，联想，小米，金立，TCL 等一款手机上最多可以卖 7-8 颗料，LDO，DCDC，运算放大器，charger，负载开关等。

工业应用：主要包括三表、安防、仪器仪表、传感器、摄像头市场等，平均毛利比消费电子高十个点。

11、 请介绍一下公司下游客户的情况。

答：公司目前注册在案的客户有近万家，实际供货的客户有 2000 家，单一客户占销售额很难超过 2%。公司与中兴、联想、小米、金立、TCL、长虹、创维、康佳、海尔、海信、海康、大疆、夏普等各行业知名企业保持密切联系。

12、 公司是如何选择合作晶圆厂的？

答：目前公司几乎所有产品均在台积电代工。台积电是目前世界规模最大的晶圆代工厂，代工量占全球的 50%以上，价格略高于同业，但是其工艺门类齐全、演进速度快，技术支持能力强，产

	<p>品稳定性好、良率高，可靠性、一致性高，供货有保证，具备综合优势，所以芯片性能和品质也相应较好。</p> <p>13、 公司的产品采用什么工艺？ 答：模拟芯片一般不需要线宽太小的工艺。公司的产品主要采用是 0.18um、0.25um 工艺，二者之和占总产品比例接近 50%。在新工艺开发方面，公司已掌握 0.18um 制程的高压 BCD 工艺，适用于消费电子，工业医疗。</p> <p>14、 请公司说明毛利率变化的原因。 答：信号链产品方面：2016 年公司积极开发工业应用领域需求，所以信号链产品毛利率有所上升。 电源管理产品方面：公司的电源管理产品有 60%用在手机领域，由于下游手机市场竞争激烈，2016 年电源管理芯片毛利率有所回落。</p> <p>15、 CAPEX 资本支出后续是维持稳定还是会持续增加？ 答：设计公司是轻资产。资本支出主要用于研发的固定资产和无形资产投入，后续会随着项目开发的进展持续增加，但不会有阶跃式的增长。</p> <p>16、 2015-2016 年按照 10%的优惠税率，未来是按照 15%还是 10%的税率？ 答：若相关国家税收政策不发生变化，公司未来仍会沿用 10%的税率。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2017 年 7 月 14 日